

レンセラー工科大学と半導体分野における合意書を締結

～両大学の連携による半導体分野の人材育成・研究活動の進展に期待～

【概要】

2024年8月20日（現地時間）、北海道大学の寶金清博総長がレンセラー工科大学（米国）を訪問し、マーティン・A・シュミット学長との間で、半導体分野における人材育成・研究活動での協力をともに検討していくための合意文書に署名しました。

レンセラー工科大学は、半導体分野の研究開発で世界有数のエコシステムを有するニューヨーク州において、オールバニー・ナノテク・コンプレックス、IBM など、この地域の半導体の主要な機関と緊密な関係を有し、半導体分野における教育及び研究において先進的な取組を行っています。

本学は、国立大学として国内最多の12学部、21大学院を有し、人文・社会・自然科学ほぼすべての領域をカバーし、およそ18,000人の学生を有しており、半導体分野における教育・研究拠点として体制強化を進めております。

寶金総長のレンセラー工科大学訪問を契機に、半導体分野の人材育成・研究力向上の必要性を共有している両大学の連携について意見交換を進め、この度の合意文書締結に至りました。

【寶金総長コメント】

北海道大学は、半導体の高度人材育成及び研究推進に関する体制構築を加速度的に進めています。

今回、米国の半導体分野において先進的な取組を行っているレンセラー工科大学と関係が構築され、半導体分野に関する連携の模索を進めることで、より質の高い教育を提供することが期待できるとともに、研究力の向上に資するものと考えています。



合意書署名後の寶金清博総長及びマーティン・A・シュミット学長（中央2名）
同席（後方左から）：小池淳義 Rapidus 社長、鈴木直道 北海道知事、レベッカ・ドールジュ
レンセラー工科大学プロボスト、ムケシュ・カレ IBM 半導体部門ゼネラルマネージャー・
ハイブリッドクラウド研究担当バイスプレジデント

（写真：レンセラー工科大学提供、撮影者：クリス・クア（レンセラー工科大学））

【参考】

レンセラー工科大学ウェブサイト

<https://news.rpi.edu/2024/08/20/rpi-and-hokkaido-university-sign-letter-intent-semiconductor-collaboration>

お問い合わせ先

北海道大学総務企画部企画課 半導体拠点形成推進本部事務室担当 上田 敦（うえだあつし）

T E L 011-706-3205 メール semicon-jimu@general.hokudai.ac.jp

北海道大学国際部国際連携課 佐藤ひとみ（さとうひとみ）

T E L 011-706-4408 メール kr-hosa@oia.hokudai.ac.jp

配信元

北海道大学社会共創部広報課（〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目）

T E L 011-706-2610 F A X 011-706-2092 メール jp-press@general.hokudai.ac.jp